行政院農業委員會農業試驗所專利權讓與意願書

附 件

申請日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 申請讓與專利權項目 | □溫帶果樹高接花穗生產方法  □BIOREACTOR FOR GROWING FUNGUS, PLANT CELL, TISSUE, ORGAN, HAIRY ROOTS AND PLANTLET (美國專利)  □自走式鑽孔施肥機  □米粒方型包裝自動化設備 |
| 申請業者  基本資料 | 公司名稱：  代表人：  電 話： 傳 真：  電子郵件：  聯絡人： 職 稱：  電 話： 傳 真：  連絡地址：  電子郵件： |

申請公司： (公司印信) 代表人： (簽章)